

株式会社アドバンテスト

2019年3月期(2018年度)第2四半期決算説明会 質疑応答要旨

2018年10月30日(火)

Q：上方修正にあたり、SoC テスト・システムの売上予想を 300 億円引き上げている。SoC テスタ好調の要因には何があると分析しているか。

A：10nm、7nm プロセスの半導体が拡大する中、半導体に高い信頼性が求められるようになっており、テスト項目が増えるとともにテスト時間も長くなっている。スマホ向けの SoC に AI 機能が入ったこともあり、SoC ビジネスは好調。ディスプレイ・ドライバ IC 向けでも想定以上に上振れしているが、特に TDDI (Touch and Display Driver Integration) の需要が増えているため。スマートフォン向けだけでなく、4K テレビ向けも良い。来年も好調は続くと考えている。

Q：中国に関し、最近 OSAT が脱中国の動きを強めているが、どう捉えているか。

A：米中貿易戦争の行方が懸念される中、中国の顧客は内製化をますます進めなければならないと考えている。中国には内資系の OSAT と外資系の OSAT があり、外資系の OSAT は中国から出る動きが始まっているが、出て行く先は台湾、マレーシアなどのアジア。我々が主力にしている地域であり、大きな影響はないと考えている。

Q：来年、期待できると考えるテーマは。

A：SoC では 7 nm 製品の拡大と 5G のスタート。5G は基地局向け市場が来年立ち上がるだろう。当社はその市場へのソリューションを開発済みで、期待している。メモリでは、DRAM のある会社は、1X 世代から 1Y 世代へ移行する。別の会社は、2Z 世代から 1X 世代への移行を加速させる。NAND は、96 層の QLC 製品が、もともと 2019 年後半の量産という計画だったが、2019 年の前半に前倒しされそう。これらでテストタイムが伸び、テスト需要が復活すると思われる。

Q：以前、2Q の受注は 1Q より下がると言っていたが、当初の想定よりどのくらい上振れたのか。およびその内訳は。

A：SoC 受注はスマホ向け中心に、約 180 億円上振れた。残りがメモリ・テスト、メカトロニクスでの受注増。

Q：中国の受注が 180 億円と増えているが、その内容と今後の見通しについて聞きたい。

A：ディスプレイ・ドライバ IC 向けの新規マーケットとメモリの新ファブ立ち上げが主な要因。新ファブはパイロットライン用、中国内資系向け。DRAM はパイロットラインから製品

が出てきたところ。テストの需要も出てきているが、2019 年後半以降、これが活発になるだろう。NAND は既に 32 層の製品が出ているが、64 層品も来年後半に生産が始まると想定しており、我々のビジネスにつながるだろう。

Q：来期も含めた SoC テスタのアプリケーション別の需要見通しは。

A：受注だと、コミュニケーションと High Performance Computing で 5 割強、MCU、アナログ、センサで 1 割強、ディスプレイ・ドライバ IC で 3 割。来期の SoC テスタ需要は、定量的には全くまだわからないが、ディスプレイ・ドライバ IC で強い需要が続くだろう。車載・産機向けは少し落ちるかもしれないが、比率としては今期とあまり変わらないと考えている。

Q：モバイル SoC で、AI 機能が搭載されているチップの比率はどのくらいか。来期はどうなるか。

A：10 nm 製品と 7 nm 製品で分けて考える必要がある。10 nm 製品は、今の新製品に AI 機能が入ってきている。2019 年になると、7 nm 製品が主流になる。そう考えると、AI 機能を入れて多機能になるのは確実。テストタイムの長時間化、テストの複雑化につながるため、期待している。

Q：これまで 2 年サイクルでテスト需要に山・谷があった。今年が山で、通常であればこれから谷になるが、AI 搭載 SoC の登場で、需要落ち込みはあまり考えなくてよいのか。

A：需要サイクルとプロセスの進化に関連があり、5 年前に 28 nm 製品が出て、2 年前に 14 nm 製品が出て、去年は 10 nm 製品がスタートした。微細化に伴い、スマートフォンに搭載されるプロセッサに AI 機能を入れることは、各スマートフォンメーカーが力を入れているところ。この流れは続くと思う。

Q：5G 市場の来年以降の見通しを聞きたい。

A：市場規模はまだ分からないが、2019 年後半から 5G 採用のスマホ、4G と 5G が両方使えるスマホが出てくると思われる。そのためには基地局が先になければならず、その関連需要が 2019 年後半から始まると考えている。本格的なマーケットは 2020 年になるだろう。当社は 5G 時代に求められるテスト機能を持ったソリューションを既に開発しており、マーケット拡大に期待。

Q：基地局向けのシェアはどのくらいか。

A：4G 向けでは 80%以上。5G でも大きなシェアを持ちたい。

Q：3Q、4Q の受注において、SoC 向け、メモリ向けそれぞれの傾向は。

A：3Q は SoC が強い。4Q はメモリが強くなると想定している。

Q：2Qの受注に前倒し分はあったのか。

A：テストのリードタイムが従来の約2ヶ月から、約4ヶ月に伸びている。それに沿って注文が入ってきているが、これを前倒しとは捉えていない。2Qが受注の底で3Qが売上の底になるのがこれまでのパターンだったが、今期はそうになっていない。いろいろなアプリケーションで半導体が使われていることで、テスト需要に季節性が薄れてきていると感じている。

Q：生産体制について。群馬工場は限界キャパに近いと思うが、工場を新設する考えはあるのか、それともEMSを活用するのか。

A：1Q、2Qともに700億円を超える売上となり、既にそれだけの生産キャパがあるということ。V93000の生産は全て海外のEMSで行っている。メモリ・テスト、T2000の生産は群馬地区で行ってきたが、最近の生産増を受け国内のEMSを活用している。海外では、韓国でも一部製品の組み立て、ハンドラの生産を行っている。生産に大きな固定費を掛けたくないと考えており、EMSを活用していきたい。

以上

※本資料に記載されている内容は、決算説明会の質疑をもとに当社の判断で要約したものです。また本資料には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務活動や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって、明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。